



台灣銘奮電子科技有限公司

Taiwan Fairfield Electronic Technology Co., Ltd.

■ 2024.10

關於銘奮



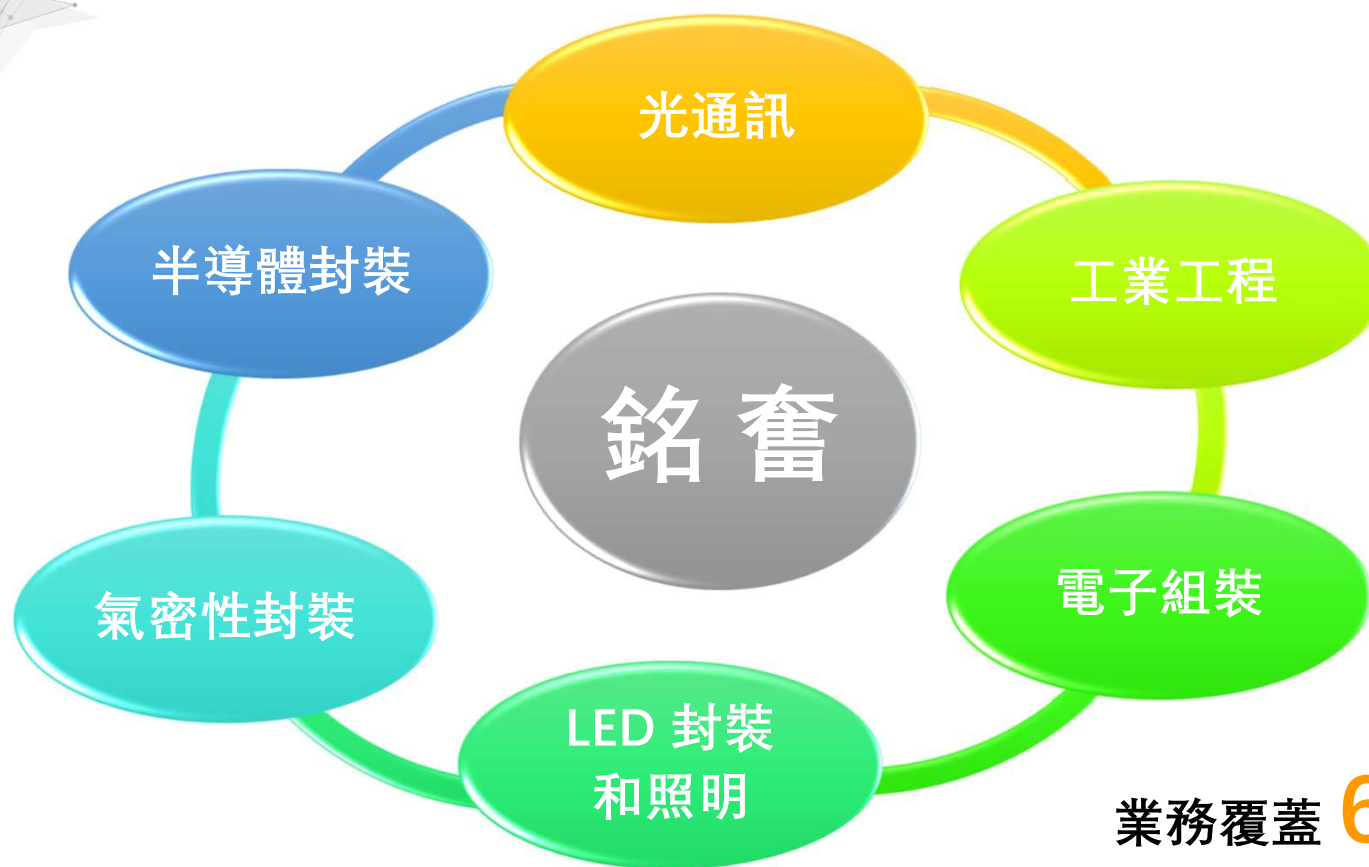
專業的技術為先導的電子材料供應商

台灣銘奮電子科技有限公司是一家以銷售各種進口電子材料為主，以提供工藝設計及解決方案、強大的技術支援為輔的高科技材料貿易公司。



業務覆蓋範圍

 **FAIRFIELD**
SOLUTION FOR YOU



業務覆蓋 **6** 大行業

公司產品 - 氣密性封裝

FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU

01 晶片粘接膠

耐高温系列

产 品	介电强度 (Volts/mil)	Tg (°C)	抗撕裂 强度 (psi)	器件抗拉拔 强度 (psi)	硬度 (Shore)	热导率 (W/m·°C)	线性 热膨胀系数 (ppm/°C)	连续工作的 最高温度 (°C)	平均粘度 (5.0rpm,25°C)	特 性
MC7865	>1000	220	>1000	>2500	95D	>1.8	28	<200	20,000cp	低CTE，低吸湿性，低离子杂质， 低介电温度，高热导率。

耐高温系列

产 品	介电强度 (Volts/mil)	Tg (°C)	抗撕裂 强度 (psi)	器件抗拉拔 强度 (psi)	硬度 (Shore)	热导率 (W/m·°C)	线性 热膨胀系数 (ppm/°C)	连续工作的 最高温度 (°C)	平均粘度	特 性
MC7883	>750									
MC7885	>1000									
MC8880	-									
MC8880-S	-									

高导热系列

高导电系列

产 品	介电强度 (Volts/mil)	Tg (°C)	抗撕裂 强度 (psi)	器件抗拉拔 强度 (psi)	硬度 (Shore)	热导率 (W/m·°C)	线性 热膨胀系数 (ppm/°C)	连续工作的 最高温度 (°C)	平均粘度	特 性
ME7155-AN	>750	-25	>1000	>1800	80A	0.17	180	<150	240,000cp	无应力，无溶剂配方，可返工，超高导热
ME7155-CD	>750	-2								
MC8880-FPSR	-	24								

高导电系列

➤ 可根據客戶具體應用要求開發
和定制配方



费尔德
Fairfield

低应力系列

产 品	介电强度 (Volts/mil)	Tg (°C)	抗撕裂 强度 (psi)	器件抗拉拔 强度 (psi)	硬度 (Shore)	热导率 (W/m·°C)	线性 热膨胀系数 (ppm/°C)	连续工作的 最高温度 (°C)	平均粘度	特 性
ME7150	>750	-25	>1000	>1800	80A	0.17	180	<150	50,000cp (0.5rpm,24°C)	可返工，无溶剂配方， 柔性电绝缘环氧粘接胶。
ME7150-SC	>750	-20	>1500	>2400	80A	0.2	120	<150	20,000cp (5.0rpm,25°C)	分子柔性，无溶剂配方， 低温快速固化，绝缘环氧粘接胶。

低应力系列

公司產品 - 氣密性封裝

02 STAYDRY® 吸氫吸濕片

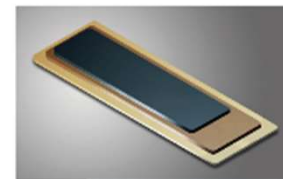


吸氫片

- STAYDRY® H2-3000
高容量氫氣吸片
- STAYDRY® H2-3000PSA
帶有易於粘貼壓敏膠(PSA)
的吸片

吸濕片

- STAYDRY® Z20
帶有PSA粘合劑的超快吸收的吸片
- STAYDRY® HiCap™ 2000
用於電信和醫療應用領域的
領先吸濕片



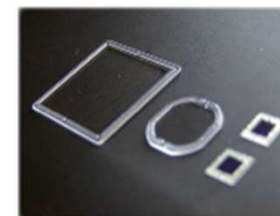
公司產品 - 氣密性封裝

FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU

03 密封蓋板 “ELEPHANE® CS”



TOMOEAWA
株式会社巴川製紙所



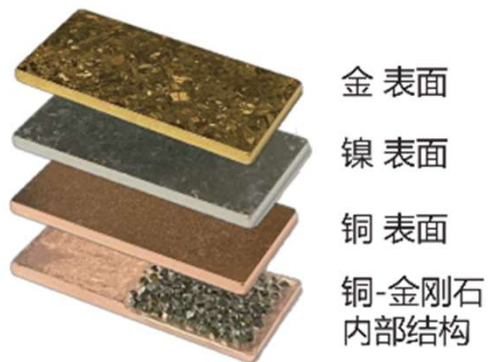
- **粘結性能:** 專門設計的粘結劑具有氣密性、耐濕、耐熱、耐回流特性。
- **塗裝技術:** 可以針對客戶設計優化塗裝工藝，通過切割工藝等各種精密技術，進行各種設計。
- 使用**高科技清潔技術**，可以使得無塵控制。
- 塗覆各種薄膜，並通過氣相沉積工藝**增強光學特性**。

公司產品 - 氣密性封裝

FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU

04 半導體熱源散熱器

TGS
THE GOOD SYSTEM CORP.



- 5G / 6G 無線通訊
- HV / EV 中的 IGBT 功率模組
- 軍事和航空航太通信
- CPU 伺服器、互聯網交換機、ASIC、可穿戴設備
- 高功率鐳射、雷射雷達

● 典型產品特性

TC(熱導率)		~1,000 W/mK
CTE(熱膨脹係數)		7~9 ppm/K @室溫
熱迴圈實驗下的高可靠性		MIL-STD-883K-C, -65°C~150°C 1000個迴圈
設計	厚度	0.2~5.0mm
	尺寸	~100mm x 100mm
	形狀	開孔型、耳朵型、梯形
	表面材料	銅、鎳、金 可供選擇
適用於 800°C 陶瓷釐焊且彎曲度 <30μm		

公司產品 - LED封裝和照明

FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU

01 高導熱銀膠 CT285

KYOCERA

- 大功率 LED
- 高功率器件
- 無溶劑型環氧樹脂晶片粘接膠
- 高達 95% 的含銀量
- **導熱係數 25W/mK**
- 低吸濕率的樹脂
- 過回流焊時穩定性高

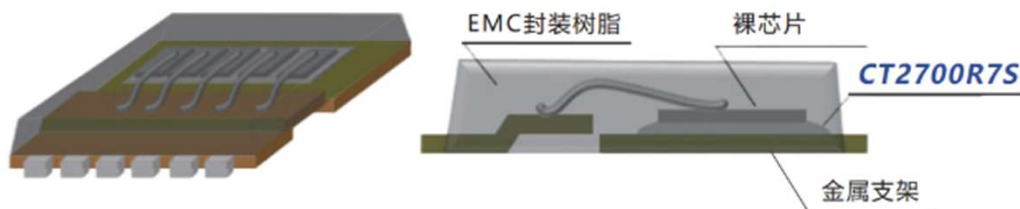


公司產品 - LED封裝和照明

FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU

02 納米燒結銀漿 CT2700R7S

KYOCERA



- 低電阻
- 高導熱率
(200 W/mK)
- 利用獨特的樹脂分散體系實現
低應力化、高耐熱、高可靠性

【替代焊料】

- 替代高溫鉛焊料
- 替代 AuSn 焊料

【器件】

- SiC / GaN 功率器件
(TO 封裝、功率模組)
- 表面發光二極體(VCSEL)
- 高功率 LEDs



公司產品 - LED封裝和照明

03 Mini LED 用焊料

REL22™ 高可靠性無鉛合金焊材

REL61™ 無鉛合金焊材



可提供的形式：焊條、焊線、焊膏



AIM的LUX系列产品
合金、无银和无空洞锡膏

可与T6合金粉末相结合，旨在改进
现有LED技术并满足未来的需求。

FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU



- 減少空洞
- 減少窩枕缺陷
- 非常低的殘留
- 無銀 / 低銀合金
- 良好濕潤
-

NC259 無鉛免洗焊膏

公司產品 - 電子組裝

01 微電子材料

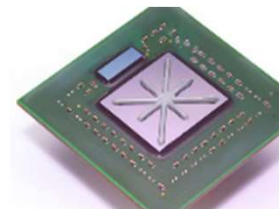
FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU

Parker | Lord

【晶片包封】

可用于焊線晶片包封、智慧卡包封或元器件固定
我們提供覆核消費級或半導體級要求的包封材料

- 操作簡單
- 低應力
- 高可靠性
- 高導熱



【裸晶片粘接】

可用於 LED、COB或各類 IC 封裝的粘接

- 單組份 / 雙組份
- 導電 / 絕緣
- 快速固化 / 低溫固化



公司產品 - 電子組裝

02 導熱材料

FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU

Parker | Lord

【導熱膠 / 導熱凝膠 / 導熱脂】

適合各類不同材料的粘接用於散熱片、倒裝晶片、變壓器、大功率LED等有散熱要求的應用

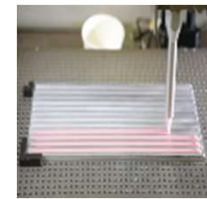
- 環氧 / 有機矽 / 特殊樹脂類
- 常溫固化 / 低溫固化
- 高強度 / 高導熱率
- 導電 / 非導電



【填縫劑】

通過使用導熱填縫劑填充表面缺陷，獲得最佳產品性能，可以緩解由溫度差異和彎曲引起的應力。

- 低揮發
可揮發的矽氧烷含量可控制到PPM級別
- 抵禦機械衝擊
能持久保持自粘性和柔軟，以起到減振的作用。



公司產品 - 電子組裝

03 灌封膠

FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU

Parker | Lord

灌封膠	產品	化學品種類	導熱率 (W/mK)	粘度 (CPS@25°C)	密度 (g/cm ³)
	CoolTherm SC-305	硅樹脂	0.7	4,000	1.5
	CoolTherm SC-309	硅樹脂	1.0	3,600	1.7
	CoolTherm SC-315	硅樹脂	1.5	4,000	2.6
	CoolTherm SC-320LVH	硅樹脂	2.1	4,500	2.8
	CoolTherm SC-320	硅樹脂	3.2	22,000	3.1
	CoolTherm SC-324	硅樹脂	4.0	30,000	3.2
	CoolTherm SC-326	硅樹脂	3.5-4.0	25,000	3.2
	CoolTherm UR-389	聚氨酯	0.7	14,000	1.5



- 雙組分
- 室溫或加熱固化
- 電絕緣
- 1:1 混合比

公司產品 - 半導體封裝

01 背面保護薄膜 / 背面研磨膠帶 晶片粘接膜(DAF) / 切割膠帶

AUD1: 常規型切割PVC膠帶



- AUD1是一款常規用晶圓切割膠帶
- 防滲漏、飛芯片、芯片缺損，易于UV照射後吸取芯片。

AUD5:

CIS(CMOS圖像感知器)用切割PVC膠帶



- 基于在CIS芯片上良好的合格率，这款胶帶被广泛应用于韩国。
- 防滲漏、飛芯片、芯片缺損，易于UV照射後吸取芯片。

AUD7: 小尺寸芯片用切割PVC膠帶



- 小尺寸芯片用的PVC切割膠帶顏色是藍色的
- 激光在膠帶上易于做標識

AUP165-HC:

小尺寸芯片切割膠帶 & 优异的標記可讀性



- 膠帶的高滲透性使條形碼更易讀
- 可以切割小尺寸PKG芯片，如0.6 * 0.3mm，沒有任何問題。

AUP170-HC: 常規PKG切割膠帶



- 這是一款具有高附着力常規PKG切割膠帶
- UV照射後，芯片可以很容易從膠帶上被釋放出來，不留下任何殘留。

FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU



部分產品

AUP1: 功率QFN切割膠帶



- AUP1可以保持固定住切割時的厚封裝體，如PQFN、陶瓷等。
- UV照射後，芯片可以很容易從膠帶上被釋放出來，不留下任何殘留。

AUP4: 小尺寸PKG用切割膠帶 & 低氣味型



- 适用于PKG尺寸为3*3mm及以下尺寸
- UV照射後低氣味，提供舒適的工作環境。

AUG2: 玻璃 & LED 切割PO膠帶



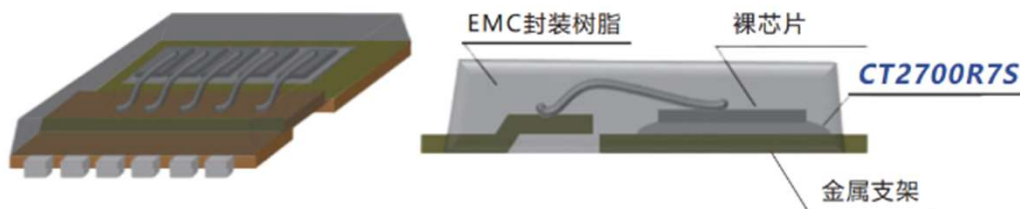
- 使用PET膜的高附着力膠帶
- 可以在芯片切割時提供材料堅強的固定，如玻璃或LED材料。

公司產品 - 半導體封裝

FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU

02 納米燒結銀漿 CT2700R7S

KYOCERA



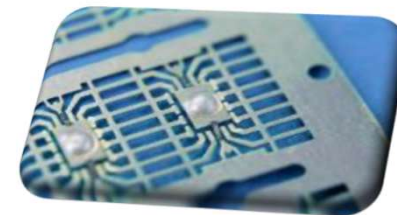
- 低電阻
- 高導熱率
(200 W/mK)
- 利用獨特的樹脂分散體系實現
低應力化、高耐熱、高可靠性

【替代焊料】

- 替代高溫鉛焊料
- 替代 AuSn 焊料

【器件】

- SiC / GaN 功率器件
(TO 封裝、功率模組)
- 表面發光二極體(VCSEL)
- 高功率 LEDs



公司產品 - 半導體封裝

03 環氧塑封料

FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU

KYOCERA

【BGA 用 EMC】

封装形式		F-BGA(细间距BGA)			
		一般		高发热芯片	
EMC	类型	普通BGA		高导热型	
	必要特性	键合 常规间隙填充		高导热 普通/狭窄间隙填充	
	成型方法	注塑成型	压缩成型	注塑成型	压缩成型
推荐产品		KE-G1250LKDS 系列*	KE-G1250AH 系列*	KE-G1250HT 系列*	KE-G1250HT 系列*
主要应用		应用程序处理器、NAND、Logic		CPU、GPU、DRAM、Logic	

* 低 α 型(KE-G2250)也可提供

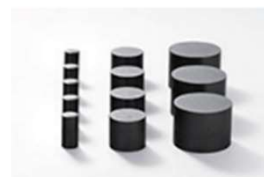
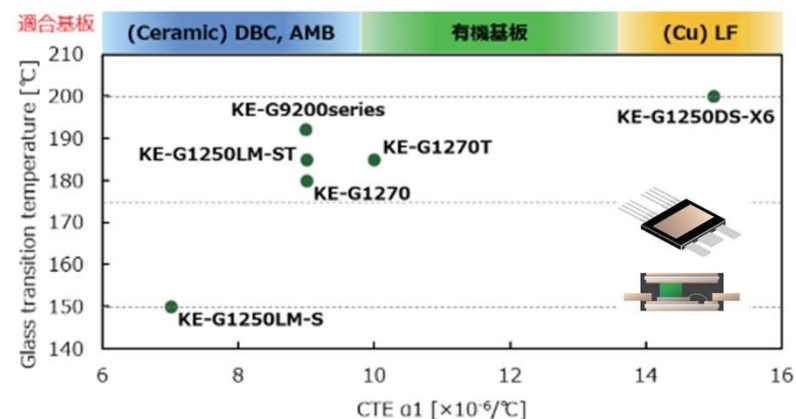
【指紋識別感應用 EMC】

高介电塑封料可以
有效提高传感器灵敏度



产品	KE-G1250AH-F 系列	KE-G1255 系列
填料类型	硅填料	高介电常数填料
成型方式	注塑成型	注塑成型 压缩成型
生产性	狭窄部良好的填充性	

【功率器件用 EMC】



公司產品 - 半導體封裝

03 環氧塑封料

FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU

KYOCERA

【Flip-chip PKG 用MUF EMC】

封裝形式		F-BGA(细间距BGA)
		Flip-chip
EMC	封裝类型	MUF(Mold Under Fill)
	必要特性	小尺寸填料树脂 狭窄部填充
	成型方法	注塑成型 压缩成型
推荐产品		KE-G1250FC系列 KE-G2250FC系列 (低 α 型) KE-G1250AH系列 KE-G2250AH系列 (低 α 型)
主要应用		DRAM、RF模组

Flip-chip下 填充状态

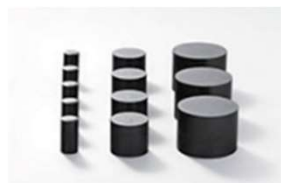


KE-G1250FC-P3W



常规材料

【LF(框架) PKG 用 EMC】



	TSOP, SOP, QFP	QFN	TO252, TO220
特点	高结合强度 低吸湿率	良好的翘曲性 与PPF框架结合强度高	高结合强度 低模量使得MSL结果良好
推荐产品	KE-G3000D系列*	KE-G3000N系列	KE-G3000DM系列

* 低 α 型(KE-G6000D)也可提供

公司產品 - 半導體封裝

04 助焊劑 / 錫膏

 **FAIRFIELD**
SOLUTION FOR YOU

 炫纯科技
ShinePure Hi-Tech

产品类别：助焊剂

产品型号	应用	产品简介
SP F-NC-1102	倒装连接 / 热压焊	免洗低残留助焊剂，不含卤素
SP F-NC-1104	倒装连接 / 热压焊	免洗低残留助焊剂，不含卤素
SP F-WC-1001	倒装连接 / 热压焊	水洗助焊剂，FC dipping用，军工用名称SP4195，不含卤素
SP F-SC-1002	凸点重熔	溶剂清洗助焊剂，不含卤素
SP F-WC-1003	凸点重熔	水洗，用于bump fusion, spin coating, 不含卤素
SP F-WC-1004	植球	印刷/针转移，纯水清洗极好，高植球良率，润湿极好，可一步到位植球
SP F-NC-2002	POP	免洗助焊剂，不含卤素
SP F-SC-1001H	困难润湿面	溶剂洗，军工用，含卤素
SP F-SC-1003H	极困难润湿面	溶剂洗，军工用，含卤素

产品类别：高铅焊锡膏

产品型号	应用	产品简介
SP F-NC-7001 (92.5Pb5Sn2.5Ag/T3)	IGBT / SMT 锡膏 / 高熔点焊	超低残留，高铅焊锡膏，不含卤素
SP F-SC-2001H (92.5Pb5Sn2.5Ag/T3)	IGBT / SMT 锡膏 / 高熔点焊	溶剂清洗用高铅焊锡膏，含卤素
SP F-SC-7001 (92.5Pb5Sn2.5Ag/T3)	IGBT / SMT 锡膏 / 高熔点焊	溶剂清洗用高铅焊锡膏，不含卤素

产品类别：无铅焊锡膏

产品型号	应用	产品简介
SP F-NC-2002 (96.5Sn3Ag0.5Cu/T5)	SIP 焊锡膏	溶剂清洗用，无铅焊锡膏，印刷/针转移，不含卤素
SP F-WC-7001 (96.5Sn3Ag0.5Cu/T5)	SIP 焊锡膏	水洗用，无铅焊锡膏，印刷/针转移，不含卤素

公司產品 - 半導體封裝

05 各向異性導電粘著膠 (ACP)

FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU



日本化学工業株式会社

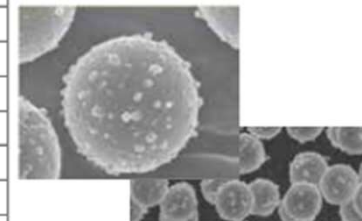
Anisotropic Conductive Paste (ACP)

一種液體型環氧樹脂粘著劑

		RL0407 标准品	RL0507 高可靠性	NF0306 快干胶	NF0606 快干胶
导电粒子	芯材	树脂	树脂	镍	镍
	金属包膜	镍/金	镍/金	金	金
	粒径	3 μm	3 μm	2.5 μm	5 μm
	添加量	5wt%	15wt%	20wt%	20wt%
粘度 (流变仪)	1[1/s]	40 Pa·s	40 Pa·s	40 Pa·s	40 Pa·s
触变性(流变仪)	1[1/s] / 10[1/s]	2.2	2.2	3.0	3.0
固化时间	150 $^{\circ}\text{C}$	20 sec.	20 sec.	8 sec.	7-9 sec.
玻璃化温度 (DSC)		125 $^{\circ}\text{C}$	125 $^{\circ}\text{C}$	128 $^{\circ}\text{C}$	128 $^{\circ}\text{C}$
线膨胀系数	α_1	68 ppm	68 ppm	88 ppm	88 ppm
	α_2	180 ppm	180 ppm	181 ppm	181 ppm
杨氏模量		2990 MPa	2990 MPa	—	—
密度		1.2 g/cm ³	1.2 g/cm ³	1.5 g/cm ³	1.5 g/cm ³
吸水率	煮沸 2小时	0.4%	0.4%	0.2%	0.2%
总氯		700ppm以下	700ppm以下	—	—
使用寿命	25 $^{\circ}\text{C}$	10天	10天	3~4天	3~4天
保质期	0 $^{\circ}\text{C}$ 以下	6个月	6个月	6个月	12个月

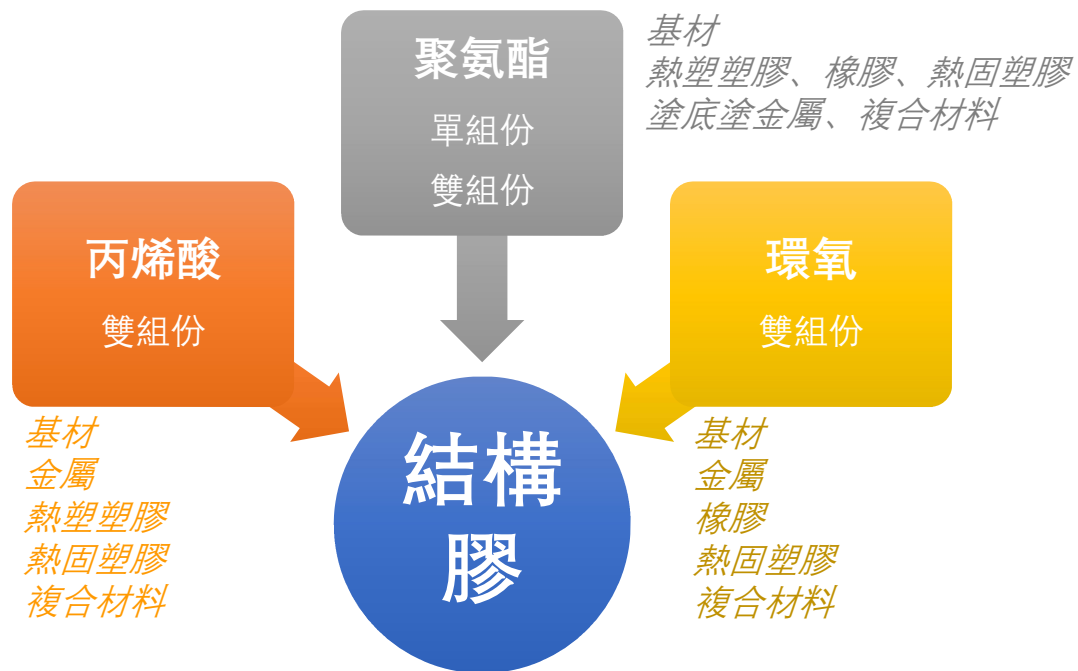


導電顆粒
3 μm 樹脂核
電鍍金-鎳的突起顆粒



公司產品 - 工業工程

01 結構膠



FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU

Parker | Lord



公司產品 - 光通訊

FAIRFIELD
SOLUTION FOR YOU

01 光纖包覆和塗層光學粘合劑

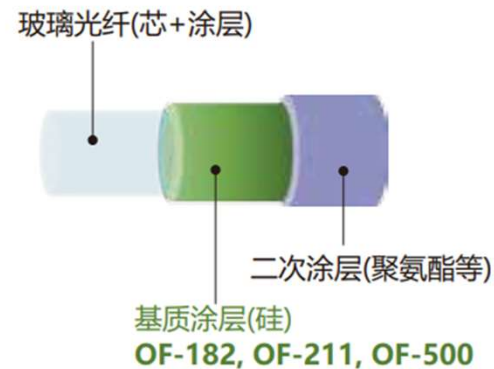
ShinEtsu

部分產品

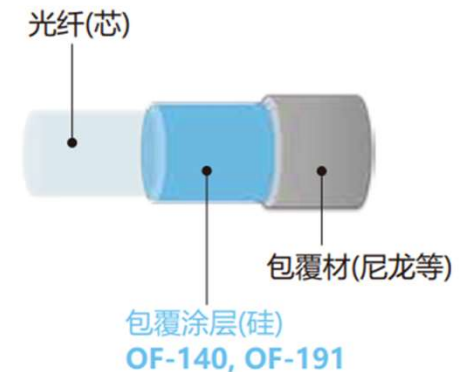
① 硅涂层结构



② 双重包覆构造



③ 硅涂层包覆构造



- 高附著力 & 高濕性
- 高耐寒性：-55℃以上保持柔軟性

- 寬折射率可選：1.33~1.53
- 高耐熱性：200℃的高可靠性
- 高防水性

我們的團隊 & 優質服務



現場支持

公司團隊時刻準備客戶現場支援的需要，盡全力確保客戶使用順利和高效運行。



專業與服務

專業快速回應客戶的需要，深入客戶現場以確定您的需求和問題點並提出改進建議。



可定制解決方案

根據客戶不同的應用需求，定制最優產品解決方案，必要時可產品或配方定制。



Thank you !

Taiwan Fairfield Electronic Technology Co.,Ltd.

Contacting Person : Tony Wang

+886 939603219

Tony_Wang@Fairfield.com.tw

